

日包工 30 第 72 号  
2018 年 10 月 11 日

各 位

一般社団法人日本包装機械工業会  
専務理事 金澤 信（公印省略）

### 『包材関連セミナー』開催のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素、当会諸事業に格別のご支援ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当会では来る 11 月 14 日（水）におきまして、高森 寛子 氏（大日本印刷株式会社 包装事業部 イノベティブパッケージングセンター 製品開発本部 開発製品拡販推進部 価値拡大チーム リーダー）ならびに内村 元一 氏（日本製紙株式会社 企画本部 パッケージング・コミュニケーションセンター 技術調査役）を講師に招聘し、包装機械会館（東京・中央区）にて『包材関連セミナー』を開催させていただきます。

つきましては、別紙記載の開催概要ならびにプログラムをご高覧のうえ、本セミナーへ奮ってのご参加を賜りますようここにご案内を申し上げる次第です。

謹白

◆本件に関するお問い合わせにつきましては、下記までお願い致します◆

一般社団法人日本包装機械工業会「セミナー」事務局（担当：井上）

住所：東京都中央区新川 2-5-6 包装機械会館 3 階（〒104-0033）

電話：03-6222-2277/FAX：03-6222-2280/E-mail：inoue@jpmma.or.jp

## 『包材関連セミナー』開催概要

1. 日 時 2018年11月14日(水) 14:00~16:45  
(第1部 14:00~15:00、第2部 15:15~16:45)  
※13:30より受付開始
2. 会 場 包装機械会館 会議室(2階)  
住所:東京都中央区新川 2-5-6(〒104-0033) / 電話:03-6222-2277  
アクセスご参考 URL: <http://www.jpmma.or.jp/industry/index.html>
3. 目 的 包装関連業界の抱える課題、社会構造の変化や海外展開、環境問題、食糧問題、生産性向上などをテーマとしたセミナーを実施し、包装機械・包装関連機器メーカーにとっての課題解決に寄与することを目的とする。
4. 概 要 第1部 14:00~15:00  
主 題:「DNPの『未来のあたりまえをつくる』パッケージ」  
～環境包材から ICT パッケージまで～  
講 師:高森 寛子 氏  
大日本印刷株式会社  
包装事業部 イノベティブパッケージングセンター  
製品開発本部 開発製品拡販推進部 価値拡大チーム リーダー  
  
第2部 15:15~16:45  
主 題:「紙でできることは紙で」  
～社会課題解決に向けた当社の取組み～  
講 師:内村 元一 氏  
日本製紙株式会社  
企画本部 パッケージング・コミュニケーションセンター  
技術調査役
5. 定 員 50名 ※お申込み先着順にて定員になり次第、締め切りとなります。
6. 参加費 当会会員:5,000円 / 非会員:10,000円  
※参加費は後日、請求書にてご請求をさせていただきます。  
※お申込後、上記締切日以降の申込取消、無連絡不参加につきましては、当該参加費を申し受けますこと予めご了承ください。また、代理出席を希望される際は、事前に事務局までご連絡ください。
7. お申込 お手数ですが、同封の参加申込書にて2018年11月9日(金)までに事務局へE-mail(inoue@jpmma.or.jp)もしくはファクシミリ(FAX:03-6222-2280)にてお申込みください。

以上